

陕西省半导体行业协会赴无锡考察

为了加强陕西与江苏协会间的交流与合作,更好的了解江苏省半导体产业发展状况与特点,学习优秀企业的经营模式,陕西省半导体行业协会组织 4 家企业于 2014 年 10 月 27 日拜访了江苏省半导体行业协会,并与江苏协会、国家集成电路设计无锡产业化基地和江苏半导体企业的主要负责人进行了座谈。

座谈会上,中国半导体行业协会集成电路分会理事长、江苏省半导体行业协会高级顾问王国平介绍了江苏协会的与会代表和协会的发展状况。座谈中,王国平理事长着重介绍了江苏省半导体产业的发展现状。双方针对半导体产业的发展现状和协会能够提供的服务内容进行了深入地沟通交流,并就协会服务工作中的经验进行了交流。双方表示此次考察对于两地协会间的更深层次合作将奠定良好的基础,下一步双方将为推动两地企业间的合作做更多的努力。

随后,陕西协会一行参观了无锡芯朋微电子,无锡华润上华和无锡市华宇芯业。参加此次考察活动的陕西企业包括:西安华芯半导体有限公司、西安芯派电子科技有限公司、西安航天民芯科技有限公司和西安欣创电子科技有限公司。对于此次区域间的交流与合作,两地企业代表均表示受益良多,对于促进两地企业间的合作也有着很重要的推动作用。

陕西省半导体行业协会联合西安高新区组织企业

参加第十二届中国半导体博览会暨高峰论坛

2014 年 10 月 28 日-30 日,第十二届中国国际半导体博览会暨高峰论坛(以下简称 IC China 2014)在上海新国际博览中心盛大开幕。本届博览会由中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国科学技术部、上海市人民政府指导,由中国半导体行业协会、中国电子器材总公司、上海市经济和信息化委员会共同主办。本届 IC China 2014 以“应用驱动,快速发展”为主题。

IC China 2014 高峰论坛由中国半导体行业协会副理事长王煜、陈硕主持,本次高峰论坛汇聚了工业和信息化部电子信息司、行业专家、IC 企业及国内外智能终端企业等产业链上下游单位。众多行业领导及权威人士共同研讨了在当前纲要推动下的中国 IC 业发展思路,核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品的整合等核心话题。

本次展会同期还举办了集成电路产业海归企业家创业创新论坛、中国 IC 设计业的新机遇及其挑战、半导体先进封装技术研发与产业化论坛会、新型功率半导体器件与应用、知识产权与产业发展环境优化、ESH 论坛等多场分论坛,以及一系列招商引资、

产品推介、信息发布等相关现场会议活动。

本次展会占地面积 12500 平方米、参展企业 200 余家、设置展位 500 多个。陕西省半导体行业协会联合西安高新区组织了西安华芯半导体、西安航天民芯、西安芯派电子、西安欣创电子等 10 多家本地企业参加了此次展会，部分企业展出了自己的产品，在展会上大家相互学习，充分交流。企业通过参加本次展会提高了自身的知名度，同时使企业对行业动态和发展方向也有了比较清晰的认识和了解。

西安航天华迅科技有限公司荣获“推动产业发展杰出贡献奖”

9月11日，中国卫星导航与位置服务年会暨博览会在北京国家会议中心隆重召开，陕西省半导体行业协会常务理事单位西安航天华迅科技有限公司以多年来专注卫星导航事业，推进产业化进程所取得的优秀成果荣获“推动产业发展杰出贡献奖”。

此次会议以“举旗卫星导航，亮剑北斗应用，乘风位置服务，扬帆智慧物联”为主题，聚集行业内精英企业。推动产业发展杰出贡献奖的设立主要为表彰为推动北斗产业化发展做出重要贡献的优秀企业，以推动卫星导航与位置服务产业快速发展。

多年来，航天华迅作为中国卫星导航领军企业，义不容辞肩负起以“中国芯”圆“导航梦”，共享北斗科技成果，推动产业发展的重任，以专业的定制化服务打造从卫星导航基础器件研发生产到行业应用解决方案策划实施，贯穿产业链的一条龙服务。2014年，航天华迅不仅推出多款高性能卫星导航芯片、模块产品，更一举拿下国内公安系统领域警务用车管理领域北斗应用项目，促进了北斗产业化应用。

来源：开发区报道

比亚迪高端手机配套生产项目落户西安高新区

10月9日下午，比亚迪公司与西安高新区签署合作协议，宣布比亚迪高端手机配套生产项目落户西安高新区。该项目是继中兴智能终端生产项目后，陕西省智能终端产业招商引资的又一重大项目，是陕西打造千亿元智能终端产业链的重要一环。

作为一家手机 ODM 制造商，比亚迪拥有从设计、研发到生产的全套设备，已为三星、华为、诺基亚等国际通讯业顶端客户提供全方位服务。此次比亚迪高端手机配套生产项目计划投资 100 亿元，一期项目预计 2015 年年初投产；建成后每年可生产手机金属机壳 6000 万套，产值合计约为 70 亿元，预计增加 3 万余个就业岗位。

智能终端产业是陕西省、西安市 2014 年以来重点发展的战略性新兴产业之一，是省市调整产业结构，保持工业稳健增长的关键举措。在智能终端产业领域，西安高新区现已吸引三星、中兴、华为、酷派等龙头企业纷纷落户。此次比亚迪高端手机配套生产项目落户高新区，意味着西安将形成从终端制造到精密零部件生产的一条龙产业链，助力陕西省打造千亿元智能终端产业。

来源：人民网

我省千亿级智能手机产业链迅速崛起

目前，我省围绕智能手机产业聚集了一批优秀通信企业集群，千亿级智能手机产业链正在崛起。未来 3 到 5 年时间里，西安高新区将成为世界最重要的智能手机产业聚集地之一，最终达到年生产 2 亿部手机，产值 2000 亿元以上，力争占有中国智能手机市场份额的 30%，占有全球智能手机市场份额的 15%。每年新增就业人口 5 万人。

今年 7 月 25 日，中兴通讯与我省签订投资协议，在我省建设西部最大的智能终端生产基地，项目一期将达到年产 1500 万部智能终端，涵盖单板测试加载、全自动化分板点胶、整机音频测试、整机软件加载等全流程自动化生产，年产值和销售收入均为 100 亿元。这不仅标志着我省已经逐步形成完整的智能手机产业链，也标志着我省打造千亿元智能终端产业形成龙头企业引领发展态势。

在核心芯片研发等产业链高端，陕西处于比较优势。如列入国家千人计划的海归人才周文益创办的华讯微电子公司，自主研发了中国第一款 GPS 芯片；由千人计划获得者任奇伟担任总经理的西安华芯半导体有限公司，其 2GbDRAM 芯片采用目前业内领先的 BWL(掩埋字线)技术进行设计，可以提供更优异的性能和更低的功耗；英特尔在西安设立的无线事业部，其手机基带芯片工艺水平已达到 40 纳米，处于国际领先水平；华天科技(西安)有限公司每年为中兴、华为、三星、苹果等企业提供主要的手机芯片及配件，移动智能终端封装产品年产值达到数亿元；基站及手机天线龙头企业摩比天线、PCB 板生产企业深圳金佰泽、五金塑胶件生产企业深圳科达利等公司也都在我省设有生产基地。此外我省还拥有龙腾手机屏驱动芯片、芯意手机多媒体芯片等一批从事芯片研发的优秀企业。

另外我省在移动终端设计方面，电源、充电器、结构件等方面以及手机应用方面，聚集了一批优秀企业抢占市场制高点。

来源：陕西日报

西安崛起“小巨人”

不沿边、不沿海、不沿江，科技型小企业如雨后春笋

在人们的传统印象中，古城西安“不沿边、不沿海、不沿江”，在科技创新方面似乎乏善可陈。前不久记者在这里实地采访时却发现，一批创新能力强、成长速度快、市场前景好的科技企业“小巨人”正在这片古老的土地上迅速崛起，成为该市实施创新驱动战略、打造经济升级版的生力军。

不久前，西安市又明确提出：到2016年底累计投入资金100亿元，实现科技企业“小巨人”总数超千家、销售收入超千亿元，形成“千企千亿带万家”的发展格局。

这一底气从何而来？西安市科技部门在培育创新“小巨人”方面有哪些新招数？

创新政府支持方式—从政府发布计划指南，到按企业需求定向扶持。

西安方元明科技发展有限公司是一家从事精密仪器仪表、设备产品生产的企业。让该公司总经理宋方颇高兴的是，公司最近重点研发的几个项目得到西安科技局的资金支持，让研发更有底气。

方元明的项目得到支持，得益于西安的科技支持新政策，即不再单纯考察项目，而是将注意力放在企业的研发实力、成长前景上，根据企业需求进行支持。而在此之前，西安市科技计划是政府制定科技计划指南，企业“按图索骥”分头申请。如今，流程完全倒过来了：实行企业创新需求统筹扶持的备案制，有需求企业先提供三年发展计划，由政府组织专家评审，根据入围企业具体需求定向扶持。

“过去，如果企业报项目完全依赖政府的科技计划，指南上面有什么我们申报什么，有些项目不一定‘对我们发展起多大作用’。”宋方说，公司还有三四十个项目需要研发，有了新政策的支持，企业就能在科技创新上大显身手。

与此同时，政府也一改单一的财政资金支持措施，综合采用无偿资助、后补助、奖励、科技金融等多种扶持方式，针对不同类型企业以及企业不同发展阶段的具体需求，在投融资、创业辅导、产品孵化、信用环境、成果转化、知识产权能力建设等方面提供有针对性的支持和服务。

此外，政府还引入竞争性分配机制，资金分配从以前的“一对一”单向行政审批变为“一对多”选拔竞争。西安市科技局负责人表示，引入竞争机制，在提高资源配置效率的同时带来了三个变化：一是科技主管部门只作行政判断，技术、产业和市场价格判断全部交给专家组评价决策；二是以绩效、公平为导向，大大提高财政资金的使用效率；三是强化了政府部门、项目承担单位各自的管理责任，解决科技项目重立项、轻管理的问题。

激活资本市场—从前银行“不敢贷、不愿贷”，现在主动“抛绣球”。

去年7月，西安万德能源成功研发全球首套十六烷值改进剂万吨级工业化装置，道达尔、雅富顿等国际知名企业纷纷表达了合作意向，但由于缺乏流动资金，拿着订单不能生产。

就在一筹莫展之际，西安科技局新的科技金融贷款扶持政策解了万德能源的燃眉之急。“我们以一项专利质押从浦发银行西安分行申请到一年期500万元科技金融贷款，这笔贷款以知识产权质押且无第三方担保，按时还款后还享受了政府贷款贴息。”万德

能源董事会秘书杨青说。他们拿到 500 万元的贴息贷款后，加快扩建生产线，如期完成了订单。

因为缺乏房产、土地等抵押实物，银行对于高成长、重技术、轻资产的科技型中小企业贷款顾虑重重，“银行不敢贷，企业贷不起”的融资困境成为制约科技型小微企业发展的瓶颈。

为破解这一融资难题，从 2013 年开始，西安市在改革创新财政科技资金投入方式的同时，激发市场金融资本的主体作用，财政专项重在引导银行、投资公司等金融机构及社会资金向企业投入。

西安市政府为此专门成立了西安投资控股有限公司，新组建了西安科技金融服务中心，前者负责科技引导资金投入，后者负责权益管理和企业再融资服务。他们先后出台了科技信贷、科技保险、科技信托等补贴、托底政策措施，累计投入资金逾 1 亿元，建立了科技信贷补偿机制、科技保险补贴机制和创业投资风险补偿机制。

通过财政科研资金引导，组织银企对接，促进金融机构产品和服务方式创新，有效缓解了企业融资难题。目前，西安科技型中小企业贷款每年支持企业逾千家，贷款余额突破 12 亿元；其中知识产权质押贷款额占 60.6%；科技企业股权融资近 20 亿元。同比增幅均在 50% 以上。“科易贷”等一大批定制金融产品应运而生。

建立科技大市场—统筹科技资源，为企业创新提供全方位服务

西安富士达科技股份有限公司是国内最大的射频同轴连接器、电缆组件及微波无源器件生产供应商。但其产品要送到远在广州的工业和信息化部电子第五研究所进行相关检测，每年光运输费就高达 100 万元。

富士达的难题反映出西安科技发展的共同难题：即有丰富的科技资源，却缺乏有助于促进科技资源流动共享机制，创新服务环境有待改善。

针对这一现象，2011 年 4 月，西安建立了科技大市场，通过开展“技术交易、设备共享、政策服务、交流合作”等一站式服务，促进大批高校院所成果转化、设备共享，吸引大批科技人才创新创业，支撑服务产业创新发展。

西安科技大市场方面了解富士达公司需求后，调研得知西安西谷微电子有限责任公司刚刚获得了国家国防科技工业局电子元器件检测的相关资质，可以提供检测服务。在其协调下，双方达成了电子元器件的检测协议，不仅为富士达节省了运输费，更满足了企业随时检测、持续创新的需求。

据介绍，目前科技大市场平台有开展服务企业的科技专家 16000 多人，注册企业 7700 多家，入网共享大型仪器设备 5500 多台（套）。科技大市场汇总整理各类关于企业发展政策，帮助企业落实加计税扣除、高新技术企业认定、技术交易等政策，累计为企业减免税额 59 亿元。

“西安不沿边、不沿海、不沿江，我们必须依靠自身科技创新优势拉动经济增长。建设西安科技大市场、实施科技企业小巨人工程、建设新兴产业创新基地是西安实现创新发展和建设统筹科技资源改革示范基地的‘三部曲’。”科技局负责人表示，西安虽然暂时还没有海尔、格力这样年产值几百亿的巨型企业，但是未来这些掌握高新技术的科技企业“小巨人”，就仿佛一颗颗潜力无限的“金种子”，将为西安的转型发展发挥更大作为。

来源：人民日报

第十二届中国半导体博览会暨高峰论坛在上海隆重召开

2014年10月28日-30日,由中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国科学技术部、上海市人民政府指导,由中国半导体行业协会、中国电子器材总公司、上海市经济和信息化委员会共同主办的第十二届中国国际半导体博览会暨高峰论坛(以下简称 IC China 2014)在上海新国际博览中心 N1 馆盛大开幕。本届 IC China 2014 以“应用驱动,快速发展”为主题,通过 12500 平方米、200 余家展商、500 余个展位的高规格迎接海内外半导体产业专业观众及买家。

10月28日, IC China 2014 在上海新国际博览中心揭开了帷幕,工业和信息化部电子信息司胡燕巡视员、上海市经济和信息化委员会邵志清副主任、中国半导体行业协会徐小田执行理事长、中国电子国际总部总经理宋健,以及中国电子学会、中国电子视像行业协会、香港贸易发展局、台湾区电机电子工业同业公会、韩国电子信息通信产业振兴会、日本电子展协会等单位的领导出席开幕式。

2014年,4G 移动互联网的商用对互联网及移动互联网等信息产业的促进有目共睹,并通过电子信息产业的高速发展辐射软硬件、移动支付、信息资讯、多媒体娱乐、运营、4G 及即时通讯等周边行业跨越式发展。有着十一届成功举办经验的 ICChina 紧随时代脉络,关注信息产业渗透至家电、汽车、医疗等行业领域这一话题,在电子产业应用带来巨大市场机遇的今天,为 IC 产业带来拥有巨大商机的集中展示空间。

据中国半导体行业协会预计,2014年国内集成电路产业销售额增幅将达到 20%,规模将超过 3000 亿元,达到历史新高。电子信息产业热点应用的爆炸式发展为 IC 产业带来的利好有目共睹,同时,由智能汽车、智能家电、智能设备及其它智能设备所带来的增长效应亦将促进 IC 产业加大研发力度,产生跨越式发展效果。据科技部网站消息称,我国极大规模集成电路制造工艺获突破,一批 65-28 纳米高端设备通过量产验证,而部分已实现批量采购,40 纳米成套工艺成功量产。IC 产业的发展对推动国家信息化和工业化深度融合有着极为重要的战略意义。一方面,高达 1200 亿元的国家级芯片产业扶持基金有望近期宣传成立,推动 IT 与移动互联产业蓬勃发展;另一方面,在互联网思维大力推动传统企业改造的大背景下, ICChina 作为最具影响力的国家级半导体产业展示平台,协同中国最具影响力的第 84 届电子展中国电子展(CEF2014)以及亚洲电子展(AEES2014)实现三展联动,共享中国电子展及亚洲电子展在电子制造业的展示优势,创造合作机遇,并实现与电子行业 60000 名专业观众及买家产生联动,从技术及贸易角度实现整合,诸多影响使本届中国 IC 产品的盛会在今年倍受关注。

IC China 2014 搭建中国 IC 产业最大贸易桥梁

作为中国 IC 芯片电子类唯一展会,本届 ICChina2014 重点展示 IC 设计与产品、IC 设计工具及服务、芯片制造、封装测试、半导体专用设备与零部件、半导体材料、集

成电路应用与解决方案、半导体分立器件、半导体光电器件、功率器件、传感器件、IC 分销、物联网、智慧城市、智能家居、便携终端、汽车电子、LED、健康医疗等展品，并通过国家“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”重大成果展区(02 专项展区)、制造展区、设计展区、封装测试展区、IC 应用及电商展区、材料分立器件六大展区集中展示年度新品。

IC 芯片为家用电器、汽车、智能终端赋予智慧与创造力，使他们进化成智能家电、智能汽车及以手机、平板电脑、可穿戴设备等多种形式的智能终端产品，而这些产品又通过移动互联为脉络，将世界连接起来，从而造福人类生活。产品的智能化、网络化是今天和未来的发展趋势，也是 IC 及周边产业所要共同努力实现的远景。

近年来的 IC China 展会上，IC 新品不仅受到 IC 产业的关注，更受到家电、汽车、智能终端企业的密切注视。同时，亦带动传感器、显示设备、PCB 等产业发展。有资料表明，在苹果最新发布的 iWatch 产品上，将至少拥有 10 种以上的传感器，同时拥有曲面 LED 显示屏及创新设计的电子布局设计，这些都说明了今天科技创新对于明天的电子制造业的推动作用。在过去的 2013 年，全球前五大 IC 设计企业分别为高通 (Qualcomm)、博通(Broadcom)、超微(AMD)、联发科及英伟达(Nvidia)，本届 IC China，全球最大的 IC 设计企业高通与另一设计业同样举足轻重的企业联发科技共同亮相，掀起现场无数关注。工研院产业经济与趋势研究中心(IEK)产业分析师陈玲君表示：“在今年，联发科技将持续扮演台湾之光角色，今年的产值有望超越超微(AMD)进而登上全球 IC 第三大设计业者的宝座。”高通(Qualcomm)及联发科的到场无异提升了 ICChina 的权威及本届展示对于产业发展的说服力，同时，海思(华为)、展讯(紫光)以及大唐微电子为代表的中国半导体设计领先公司更加关注中国市场，齐聚 ICChina2014。台湾联华电子、中芯国际、华润微、瑞萨、京瓷、东京精密、东电、迪思科为代表的芯片制造、封测和支撑企业;高通、飞思卡尔、IDT、安森美为代表的欧美设计原厂均将到场，凭借参展品质量和参展企业在业界的影响力，使本届 IC China 2014 的关注度达到历届之最，更多企业如以 Cadence、Synopsy、Freescale、台积电为代表的芯片商鼎力支持赞助 IC China 高峰论坛。

中国参展企业方面，随着国家对 IC 电子产业培育扶植计划浮出水面，将为中国自主 IC 企业注入澎湃动力，以紫光集团、中国电子信息产业集团及大唐电信为代表的未来三大 IC 集团整体亮相 ICChina2014，完成新产业结构下的集团首秀。其中，紫光集团旗下著名 IC 设计制造商展讯将参加 ICChina2014。正在积极布局中的 CEC 将组建新的 IC 领域航母集团，华大、华虹、澜起、贝岭、中电器材等均将系数亮相 ICChina2014。而大唐电信已经整合旗下联芯科技、大唐微电子，成立了大唐半导体设计有限公司，同时参股中芯国际，使大唐拥有芯片平台集设计、制造于一体的航母级 IC 企业群。三

大集团积极进行产业整合，整合后的新公司将极大地提升国产芯片在国际市场的综合影响力。本次国产三大芯片设计企业的集体亮相为 ICChina2014 带来丰富看点。

随着极为丰富的海量展品及业界第一手技术资讯共同亮相 IC China 2014，本届 IC China 2014 将极大的带动中国电子产业贸易发展，IC China 2014 欲打破行业壁垒，缩短沟通的沟壑，凭借在 IC 产业多年来的影响力和良好口碑，为 IC 产品及电子产业甚至汽车、家电等产业提供最具效率的平台，实现产业间的贸易共赢。

数十场专业活动发出业界最权威声音

IC 芯片作为电子产业及智能家电、智能汽车等产品的最核心部件，其发展方向将直接引领家电、汽车等产品的未来发展趋势。IC China 2014 将给产业间提供直面对话的机会。来自全球的 IC 制造商、芯片商、电子制造企业、电子元件生产企业以及智能家电企业、智能汽车企业等将通过丰富的现场活动、权威的高峰论坛以及面对面的贸易沟通等活动促进产业整合，进行高效沟通，规划未来方向，共同翘首未来。本届 ICChina 与电子界另外两个极具影响力的展会——代表基础电子与智能汽车的第 84 届中国电子展及代表终端消费电子的 2014 年亚洲电子展共同展出，实现“三展联动”，实现从上游芯片到终端产品全产业链无缝对接，并共享来自其它两场大型展会的专业观众，使 IC China 2014 活动更具专业影响力，并透过第三方平台提升本次大展对于产业的整体凝聚力。

名为“应用驱动，快速发展”的 IC 产业高峰论坛作为展会期间的最主要高峰论坛成功举办，此次高峰论坛由中国半导体行业协会副理事长王煜、中国半导体行业协会副理事长陈硕主持，本次高峰论坛汇聚了工业和信息化部电子信息司、行业专家、IC 企业、集成电路企业及国内外智能终端企业等产业链上下游单位。众行业领导企业及单位共同研讨了在当前局势纲要推动下的中国 IC 业发展思路初探；核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品的整合；极大规模集成电路制造装备及成套工艺等核心话题。高峰论坛邀请了工业和信息化部电子信息司副司长刁石京、“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”重大专项专家组组长魏少军、“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专家组组长叶甜春、华芯投资管理公司总裁路军、美国半导体产业协会总裁 Brian Toohy、中芯国际集成电路制造有限公司 CEO 邱慈云、TEL 集团陈捷、创维集团彩电事业本部总工程师吴伟等共同研讨中国集成电路产业腾飞之路。

除此之外，2014 中国电子采购与供应链管理高峰论坛、中国 LED 产业健康发展高峰论坛、2014 年中国电子制造装备智能化与机器人高峰论坛等等，以及影响我们未来科技生活的医疗电子创新论坛、2014 中国国际智慧家庭高峰论坛、2014 可穿戴设备技术开发与制造论坛、IC 咖啡系列沙龙：3D 打印、设计和应用等活动的举办为未来 IC 产业发展带来一个又一个的供参考实例、集成电路产业中海归企业家创业创新论坛、

中国 IC 设计业的新机遇及其挑战、半导体先进封装技术研发与产业化论坛会、新型功率半导体器件与应用、知识产权与产业发展环境优化、ESH 论坛以及一系列招商引资、产品推介、信息发布等相关现场会议室活动在 ICChina 展会期间带给业界最权威的声音。

创客与方案展示区为产业合作触发灵感

在 IC China 2014 上，有一个展区令人倍感新鲜，它就是 2014 中国电子开发者、创客与方案展示区。以“创客改变生活，智慧成就梦想”为题的开发者、创客与方案展示区汇聚创客们灵感的火花，他们用思绪与知识为一个个冰冷的 IC 通过 PCB 与元器件赋予其生命。随着越来越多的硬件企业进行硬件开源，创客们如鱼得水，通过灵感的汇聚为产品带来更多功能，积跬步以至千里，创客们凭借创客精神正逐渐的改变产业发展的大方向，IC China 关注创客群体与创意产品，在特设开发者、创客与方案展示区的同时，更深入创客群体，举办 2014 电子工程师社区大展示及创客交流活动，并将于 2014 年 10 月 30 日开展创客产品汇集发布活动。系列活动鼓励创客创新，在这里，电子开发者、工程师、创客们可以面对面的进行技术交流与切磋，灵感的迸发可以实现一项功能，而想法的相互交融则足以改变世界。

IC China 2014 及两大电子业界顶尖展会的共同举办，实现了电子制造全产业链的无缝对接，从芯片到终端，从方案到极客创新，包括对移动互联文化的新解读、对前沿技术的传播与整合、对产品与应用跨界交流及对线上线下载贸易渠道的拓展等，丰富的话题必将衍生出更多的产品与价值，参与者通过对技术与市场的准确把握，带动产品创新提升自身核心竞争力。

本届 IC China 2014 的成功举办，是中国 IC 产业的年度重大事件。IC China 2014 整场展会的全部活动均围绕着 IC 产业发展将优化人类未来生活这一远景目标，为不同的参与者搭建合作平台，促进贸易发展。同时，更深层的意义是本次展会将来自政府主管部门代表、产业协会代表以及来自全球的 IC 产业、电子制造产业、汽车家电产业、智能终端产业代表和身为个体的极客们汇聚一堂，将参与者与展品价值共同提升到人类未来科技水平的层次上来，通过参与者们灵感的碰撞，许许多多的梦想将化作现实。在本次展会上，我们很欣喜地看到中华民族 IC 产品的迅速跟进，并逐渐在产业圈内占据中流砥柱的重要位置，通过贸易合作与资源整合，相信在不远的将来，更多的来自民族的电子产品将凭借中国制造所独有的核心竞争力，在全球市场吹响胜利的凯歌。

来源:中国半导体行业信息网

IC China 2014 高峰论坛隆重召开

主题为“应用驱动、快速发展”的 IC China 2014 高峰论坛于 10 月 28 日在上海卓美亚喜马拉雅酒店举行。此次高峰论坛汇聚了工业和信息化部电子司、行业专家、IC 企业、集成电路企业及国内外智能终端企业等产业链上下游单位。众行业领导企业及单位共同研讨了在当前局势纲要推动下的中国 IC 业发展思路;核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品的整合;极大规模集成电路制造设备及基础材料等核心话题。

华芯投资管理公司总裁路军介绍了国家集成电路基金的募集规模、组织形式以及基金的投资形式，基金投资的总体思路是“紧紧围绕国家集成电路产业发展推进纲要确定的发展目标，按照市场化运作、专业化管理，积极探索国家战略与市场机制有机结合的运作机制，为集成电路产业跨越式发展发挥作用，同时为股东创造良好的回报”，基金重点支持芯片制造环节，同时考虑设计、封装测试、设备和材料等领域；以股权投资为引导，推动骨干龙头切也优化治理结构，促进兼并重组，治理推进国际并购，加强技术、人才引进，努力推动一批企业进入全球第一梯队。近期，基金投资思路主要是抓住 28nm 工艺和第四代移动通信（4G）发展的时间窗口，以重点芯片制造、设计、装备企业为依托，启动一批重点投资项目，做紧资源整合，努力实现良好开局。

“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专家组组长叶迎春介绍了当前中国集成电路产业中制造、封测、装备、材料的发展规模和基本情况，共同探讨了集成电路产业发展需要产业链、创新链、金融联协同推进的必要性。总结了集成电路产业投资的特点：“大投入，大收益；中投入，没收益；小投入，大亏损”，分析了当前中国集成电路投资具有投资规模不足和不持续的特点，会影响到行业的长远发展等等。而对于本土半导体装备和基础材料，则认为：本土企业的的关键是准确的把握客户的关键需求，进行设备的改型和进一步研发，以反应速度的灵敏性来打破目前半导体设备和材料基本被国际公司垄断的局面。

魏少军教授针对目前《纲要》推动下的中国 IC 产业发展思路初探发表了他的看法，魏少军教授通过详尽的数据分析了《纲要》2015 年集成电路产业销售收入超过 3500 亿，以及 2020 年集成电路全行业收入年增速超过 20%，中国集成电路产业收入占全球的 30%以上，国内市场占有率 50%，主要产品部受制于几个目标实现的可能性。魏教授分析认为《纲要》所要求达到的目标，都存在一定的压力，并且如果要想实现这样的目标，从现在开始到 2020 年需要对整个集成电路产业投入 800 亿美元，才有可能实现《纲要》的目标。同时，魏教授还提到，当前由于《纲要》的提出，导致很多集成电路企业价值虚高和出现产业泡沫，如果避免这样的情况出现，也是值得《纲要》实施过程值得思考的。

半导体

半导体产业呈现三大趋势

从全球来看，半导体芯片及相关领域持续的技术进步推动了现代信息通信产业的持续高速发展，其本身也发展成为一个包含了设计、加工制造、封装检测等各主要环节、年销售额 3000 亿美元的庞大产业群，当前呈现出分工合作、资金密集、结盟研发等三大发展趋势。

首先，集成电路产业专业化分工趋势十分明显。专家指出，目前集成电路产业最重要的模式变化，就是从一体化发展的主导模式演变为目前的专业化分工协作的模式。推动此模式形成的，是技术进步与竞争格局的变化。

与以往 Intel、三星等企业集设计、制造、封装等上下游于一身的发展模式不同，如今集成电路产业专业化分工越来越细，也出现了许多分别专门从事集成电路设计、封装、测试的企业。

其次，资金密集、投资经费高成为代工制造环节的重要条件。受摩尔定律支配，芯片复杂程度和工艺水平不断提高。当前全球芯片制造量产工艺技术已达到 20 纳米，随着技术水平和加工工艺复杂程度的提高，芯片加工企业的投资成本迅速增加。

半导体行业协会副理事长魏少军说，如今投资建设一座能为维持盈亏平衡的先进芯片制造厂，至少需要 120 亿美元。在这种情况下，以往由一家企业从设计到制造的集成模式，渐渐转为剥离芯片加工制造资产，转型为设计企业，将集成电路生产制造的工作委托给专门的集成电路代工企业。

这也对全球集成电路代工产能的需求急剧提升，给台积电、Globalfoundries、中芯国际(SMIC)等专门从事集成电路代工业务的企业提供了发展机遇，而三星公司、英特尔等拥有自己的芯片设计能力和芯片制造能力的企业也计划承接代工任务。

第三，由于研发费用高企，一些西方国家的研究机构之间组成了小型联盟。中科院半导体研究所研究员吴南健指出，国际上最先进的技术肯定不会让给我国，比如国际上形成了比利时研究机构 IMEC 和 IBM 为阵营代表的研发团体，为开发新设备抱团取暖，并对我国形成狙击。

来源:OFweek 电子工程网

2014 年中国半导体分立器件发展现状

1、我国半导体分立器件分布现状

我国半导体分立器件产业地区分布相对集中。按国内半导体分立器件行业销售总额比重分布，其中长三角地区占 41.3%，京津环渤海湾地区占 10%，珠三角地区占 43.2%，其他地区占 5.5%。我国生产分立器件的企业主要分布在江苏、浙江、广东、天津等省市，占到全国的 76.4% 以上。

2、半导体分离器件市场规模

前瞻产业研究院发布的《2014-2020年中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》显示：2009-2013年，中国半导体分立器件产业销售额逐年上涨，2013年均为最大值，但是增速呈现波动趋势。2010年，2013年，中国半导体分立器件产业销售额为1135.40亿元，同比增长28.50%，增速为近年来的最大值。2013年，中国半导体分立器件产业销售额为1642.50亿元，同比增长18.17%，增长速度有所加快。

3、分立器件的发展趋势

事实证明，半导体分立器件仍有很大的发展空间。半导体分立器件通常总是沿着功率、频率两个方向发展，发展新的器件理论、新的结构，出现各种新型分立器件，促进电子信息技术的迅猛发展。

一是发展电子信息产品急需的高端分立器件，如Si、GaAs微波功率器件、功率MOS器件、光电子器件、变容管及肖特基二极管等。随着理论研究和工艺水平的不断提高，电力电子器件在容量和类型等方面得到了很大发展，先后出现了从高压大电流的GTO到高频多功能的IGBT、功率MOSFET等自关断、全控型器件。近年来，电力电子器件正朝着大功率、高压、高频化、集成化、智能化、复合化、模块化及功率集成的方向发展，如IGBT、MCT、HVIC等就是这种发展的产物。

二是发展以SiGe、SiC、InP、GaN等化合物半导体材料为基础的新型器件。

三是跟踪世界半导体分立器件发展趋势，加强对纳米器件、超导器件等领域的研究。

四是分立器件封装技术的发展趋势仍以片式器件为发展方向，以适应各种电子设备小型化、轻量化、薄型化的需要。封装形式的发展，一是往小型化方向发展，由常用的SOT-23、SOD-123型向尺寸更小的，如SOT-723/923、SOD-723/923、DFN/FBP1006等封装型式发展；二是片式小型化往功率器件方向延伸，从1W功率的SOT-89一直到功耗10W的TO-252以及功率更大的大功率封装，如TO-247、TO-3P等；三是另一类则望更大尺寸、更大体积以满足各类更大功率的新型电力电子封装，如全压接式大功率IGBT及各类模块封装等。

来源:华强资讯

GSA: 2017年全球半导体产值可达4千亿美元

全球半导体联盟(GSA)在台首发“半导体全球影响报告”，根据该报告指出，2012年全球半导体产业创造2,900亿美元产值，直接、间接为全球国内生产毛额(GDP)创造了2.7兆美元；预估2017年全球半导体产业将可望创造出4,000亿美元的产值。

报告指出，2012年半导体产业提供全球130万个高经济价值的工作机会；其中，美国约有24万名半导体从业人员，日本、南韩、欧洲分别有超过10万人，台湾及中国大陆则分别有18万及22万人。报告表示，半导体产业对行动通讯、汽车、医疗照护、能源等领域创新都带来显著影响，未来还可应用在分子科学、虚拟实境及机器人等领域。

GSA并对各国政府提出建言，认为半导体业需不断投资在研发，需仰赖教育体系

培养未来的科学家和工程师；各国政府应确保科学、技术、数学及工程领域有充分资金与奖学金，并规划更多相关课程，让人才更多元，确保产业竞争力。

GSA 亚太领袖议会主席暨钰创董事长卢超群表示，半导体是数位世界的根基，为创新、创富(创业)、创现代文明的三创产业。他指出，台湾半导体产业产值排名已跃居世界第 2 位，需要政府认同这个产业，并且协助企业创造更健全的产业链，让台湾能够在更好的环境培养人才、根留台湾。

来源：精实新闻

中国半导体产业强势崛起威胁国外厂商

中国急着发展半导体产业的原因之一，是半导体已成为中国第一大进口商品，对于发展进口替代的大陆经济，确实为首要替代目标。去年中国半导体晶片产品进口达 2,313 亿美元，正式超过原油进口，贸易逆差达到 1,436 亿元。另外一个原因则为国家安全问题，2013 年美国接连爆发“棱镜门”、“监听门”事件，大陆政府意识到科技安全问题的重要性，“去 IOE” (IBM、Oracle 和 EMC) 的核心思考策略，正式提高到国家战略发展的高度，而半导体一直处于资安的核心位置。中国目前通讯设备、政府、金融机构等所使用之工业电脑、伺服器晶片多为欧美厂商提供，基于国家安全考量，大陆积极推行 IC 国产化。在这两大理由加持下，未来五年大陆半导体产业将成为大陆政府主要的扶持对象。

国外厂商也嗅到相关的威胁，高通在受到中国政府启动的反垄断调查后，随即宣布将 28 奈米(nm)手机晶片生产部分转到大陆晶圆代工中芯国际，向中国政府示好。中国内需市场大，具备话语权的份量，也是大陆积极使用的武器。大陆中兴通讯自主研发的 LTE 多模晶片平台，通过中移动认证，打破了国外晶片厂长期垄断的地位。这些都显示中国半导体透过引进国外先进技术，晶片自主化加速其进口替代的政策发展。

对台湾半导体产业主要的冲击，来自大陆已经在发展的封测产业。为了因应未来的产业扶植计划，大陆中芯国际与江苏长电已合资兴建月产能 50k 片 12 寸凸块加工(Bumping) 厂，共同打造 IC 制造的本土产业链。此外，江苏长电可能进行海外并购，买下世界封测代工第四名、市占率 6.9% 的新加坡封测厂星科金朋(STATSChipPAC);江苏长电加上 STATSChipPAC，市占率可达到 9.8%，将正式成为世界第三大封测厂。在晶圆代工部分，虽然大陆最大的晶圆代工厂中芯国际市占率仅 4.6%，尚不足以对台湾业者构成威胁，但中芯在中国政策扶持及外资的帮助下，预期 5 年内市占率将成长到 9% 左右，进入世界前三大。

面临中国半导体产业强势崛起的冲击，台湾半导体产业过去虽然累积下雄厚的实力，但也应谨慎提防，并积极开发蓝海市场，强化自身利基。例如，大陆虽然在十二五规划中，积极支持发展微机电系统(MEMS)，但目前 MEMS 市场主要由欧美 IDM 及 Fabless 厂把持，厂商集中度高，中国市占率仍极低，而穿戴式装置与物联网的兴起，相关 MEMS 需求预期将持续攀升，如何积极切入 MEMS 供应链，将是台湾半导体产业的重要课题。

虽然大陆半导体崛起对台湾半导体产业立即的冲击并不明显，但半导体类出口向来是

台湾的大宗，累计今年1~7月，半导体相关出口占整体海关出口总值接近3成，是台湾今年出口成长贡献的主力，半导体相关产品出口自今年2月起便大幅走升，且几乎每个月都维持在7%以上的累计增幅，反观其他产业出口累计成长于5、6月贡献度几乎为零，7月也仅小幅贡献0.4个百分点。

来源:工商时报

第三季度大陆 AP 出货增长 11.7%

根据 DIGITIMES Research 计算，2014 年第 3 季大陆智能手机 AP 市场出货年成长为 25.1%，较前季成长达 13.6%，但季成长则仅达 11.7%，较前季衰退 1.5%。虽然 LTE 议题带动整体手机市场，但 3G 产品需求急速冷却，使得整体出货成长未若预期般爆发。

3Q'14 大陆智能手机 AP 平台转换 LTE 产品为主要出货成长推动力。2014 第 3 季大陆智能手机 AP 市场受 LTE 市场布局影响而有明显成长，出货季成长为 11.7%。

部分智能手机厂商库存因素仍在，因此阻碍了芯片的拉货力道，第 3 季出货状况虽有 LTE 议题，但成长未若预期。

来源: DIGITIMES

台积电 28 纳米 稳抓 80%市占

台积电资深副总经理暨财务长何丽梅昨(18)日表示，台积电在 28 纳米制程持续推出新技术版本，来保持领先地位；并对 2015 年 28 纳米市占率维持 80%以上，十分有信心。何丽梅昨天出席在台积电七厂举行的竹科环厂电动巴士启用典礼，并于会后接受媒体采访。

因应终端产品低价化趋势对供应链带来的降价压力，晶圆代工龙头台积电日前大动作宣布，推出低价版的 28 纳米制程「28HPC」，诉求兼具低功耗和最佳成本效益，并已获得联发科旗下晨星、展讯、新思等十家客户采用，年底前还会有 70 件新品设计定案。

台积电 28 纳米制程技术，遥遥领先跟进量产的竞争对手。台积电一直推出绩效更好的 28 纳米制程技术，方案已涵盖：低功耗制程、28 纳米高效能制程、28 纳米高效能低功耗制程、28 纳米高效能行动运算制程，及低成本暨精简型 28HPC 制程。

来源:经济日报

台湾半导体产业持续维持高成长

在 Apple Watch、物联网等新产品、新应用的带动下，预期 2015 年全球半导体市场规模约可达 3,363 亿美元，较 2014 年增长 3.1%。台湾半导体产业方面在中低阶智慧型手机需求持续增长下，以及新款智慧型手持产品与穿戴装置带动台湾供应链出货，预期 2015 年台湾半导体产业产值将达 22,136 亿元新台币，成长率约 6%，优于全球平均

水准。

2015 年台湾半导体产业产值预期成长 6%

资策会 MIC 预估，受到智慧型手机等下游终端产品的需求成长带动，2014 年全球半导体市场规模可望达到 3,262 亿美元，较 2013 年成长 6.7%。台湾半导体产业 2014 年整体产值将成长 16%，达到 20,894 亿元新台币。

资策会 MIC 产业顾问洪春晖表示，受惠于商用换机潮驱动个人电脑（PC）产品需求回温、中低阶智慧手持产品热度维持，以及先进制程与高阶封装比重持续上升，2014 年台湾半导体产业可望维持高成长。

2014 年台湾 IC 设计产业成长 13%

资策会 MIC 统计，2014 年台湾 IC 设计产业产值可达 5,274 亿元新台币，较 2013 年成长 13%，表现优异，主要成长力道来自 PC 产品需求回温、4K2K 大电视需求成长带动、以及中低阶智慧手持产品出货成长优于预期等因素的影响。

展望 2015 年，智慧手持产品成长虽然渐缓，4G 晶片市场将面临新一波竞争，不过因新兴智慧穿戴式产品及物联网等市场升温有利于台湾业者。资策会 MIC 预估，台湾 IC 设计产业仍可维持稳定成长动能，2015 年产值将达 5,590 亿元新台币。

2014 年台湾 IC 制造产业成长 19%

资策会 MIC 预估，2014 年台湾 IC 制造产业产值可达新台币 11,550 亿元，较 2013 年成长 19%。资策会 MIC 产业顾问洪春晖表示，台湾晶圆代工产业受惠于行动通讯产品需求，28 奈米以下先进制程产值持续成长，且面板驱动 IC、指纹辨识等应用带动成熟制程市场发展，主要业者产能均达满载，以及记忆体供需趋于均衡，价格恢复稳定，带动台湾 IC 制造业产值大幅成长。

展望 2015 年，台湾晶圆代工市场在 20 奈米以下制程比重将持续提升，预期仍维持两位数的成长表现。在记忆体产业方面，因供需趋于平衡，价格回稳，产值恐有下滑空间。整体而言，2015 年台湾 IC 制造产业产值预估可达新台币 12,236 亿元，其中，晶圆代工产业的成长幅度可达将近 10%。

2014 年台湾 IC 封测产业成长 11%

2014 年台湾 IC 封测产业在通讯晶片及消费性电子产品之需求带动下，整体封测产值呈现成长态势。其中，4K2K 大电视带动面板驱动 IC 使用数量增加，指纹辨识、MEMS 感测器等新产品，则带动高阶封装制程需求增加。资策会 MIC 预估，2014 年台湾封测产业产值约新台币 4,070 亿元，较 2013 年成长 11%。

展望 2015 年，由于智慧型手机市场维持成长，对感测元件搭载比重呈增加趋势，同时受惠于 4GLTE 智慧型手机换机需求，带动系统级封装(SiP)或 2.5D、3D 等高阶封装制程需求，预期 2015 年台湾封测产业产值可达新台币 4,310 亿元，成长幅度约 6%。

来源:CTIMES

拯救缺“芯” 手机和汽车电子领域成扶持重点

近年来，国家各有关部门都加大了对北斗产业的扶持力度，出台了包括《国家卫

星导航产业中长期发展规划》、《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》等一系列政策。除了发改委，工信部、交通部等多部委正在酝酿北斗导航产业扶持新政。

工信部电子信息司副司长刁石京在会上表示，2014年工信部将重点支持北斗在手机和汽车电子等消费电子领域的应用示范，加强北斗服务网络 and 后端业务平台建设。

在手机方面，将组织国内骨干手机终端及芯片厂商，重点支持北斗智能手机研发与应用，推动北斗智能手机规模应用。同时，引导运营商开展基站辅助北斗网络建设，提升用户体验，以网络部署促终端应用；在汽车电子方面，计划联合相关部门共同推动北斗在汽车电子领域的应用示范。加强车联网服务平台在整个汽车产业链的规模化应用，从以卫星导航为应用主体转变为卫星导航与移动通信和互联网等信息载体融合，促进车载北斗导航终端规模应用。

刁石京认为，北斗在以手机和汽车电子为代表的消费电子市场具有广阔应用前景，核心芯片是北斗在消费电子领域应用推广的关键，随着国产智能手机厂商的崛起，产业“缺芯”局面将逐步扭转。

业内人士指出，车载导航和以智能手机和位置服务为代表的移动互联网，是目前北斗在民用领域规模最大发展最快的两个市场。工信部对消费电子市场北斗应用的扶持，将加速北斗产业在手机、汽车电子等市场的快速发展。

此外，交通部将通过开展行业第二个北斗示范工程“基于北斗的中国海上搜救信息系统示范工程”等多种方式，进一步拓展北斗系统在交通运输行业内的应用。此前，交通运输行业采购了市场上85%以上的北斗终端，创造产值达2亿多元。国家测绘局将建设覆盖全国的实时定位精度达厘米级的中国卫星导航定位服务系统，对国家级基准站进行升级改造，加装北斗接收机。住建部将在智慧城市试点推进北斗技术应用，推进北斗系统在城市应急、地下管网监测等方面的应用。

来源:中国证券报

集成电路封装行业成长空间巨大 将形成产业闭环

全球集成电路行业指标显示出行业的景气度持续上升，而出于产业发展和信息安全考虑，我国发布IC产业发展目标，各地方政府也不断落实具体政策。在此背景下，东方证券认为集成电路行业将有望迎来较大发展机遇。而封测作为我国IC产业中实力较强的重要环节，也将有望迎来巨大的发展空间。

摩尔定律失效推动技术发展

半导体行业最重要的定律就是摩尔定律，指集成电路上可容纳的晶体管数目，约每两年便会增加一倍，性能也将提升一倍。但一旦芯片上线条的宽度达到纳米数量级时，相当于只有几个分子的大小，这种情况下材料的物理、化学性能将发生质的变化，致使采用现行工艺的半导体器件不能正常工作，摩尔定律也就面临“失效”。

堆叠式封装技术将超越摩尔定律。后摩尔时代集成电路若想继续满足电路的高性能和特殊功能需求，除了通过工艺缩小CMOS器件尺寸、探索新材料、电路新结构的方法外，最可能通过封装方式的改变来提高集成电路容纳性：以系统级封装(SiP)为代

表的功能多样化道路列为半导体技术发展的新方向，着眼于增加系统集成的多种功能，而不是过去一直追求缩小特征尺寸和提高器件密度。

未来将形成产业闭环

我国 IC 封装市场起步晚，但增速快，行业规模近年来占全球比例也在不断上升，2013 年已高达 36%。我国封测行业产值在过去十年始终保持在我国半导体总产值 40% 以上的较高水平，主要是由于在半导体产业链上，封装与测试环节具有技术壁垒相对最低、劳动力成本要求最高和资本壁垒较高的特点，中国最适合半导体封装测试行业发展。

在封测整个产业的快速增长拉动下，我国本土的封测企业如长电科技、通富微电、华天科技等也得到了较快的发展。近一年来，国内集成电路行业拉开了兼并整合的帷幕，多家企业兼并收购相关企业，或与相关企业建立合作关系，形成协同发展效应。在兼并整合后，巨头集团将逐渐明晰，企业利用协同效应提升国际竞争实力，国产集成电路产业链将逐渐形成闭环。

来源:华强

台企 12 英寸破冰之举 利好大陆封测产业

台湾第二大晶圆代工企业联华电子 10 月 9 日公告，拟与厦门市政府及福建省电子信息集团成立合资公司，运营 12 英寸晶圆代工业务。项目总投资预计达 62 亿美元，其中联电将于未来五年投入 13.5 亿美元。

海外巨头顺水推舟、分食蛋糕的又一案例在 9 月 29 日的点评中，提出的“顺水推舟，分食蛋糕”是海外巨头面对大陆 IC 产业政策的基本策略，今年 4 月以来有 6 起合作案例。与台积电(规模造血能力)、格罗方(石油美元)、中芯国际(中国政府资金)相比，联电一直未能解决巨量、长期的资金来源问题。8 月份联电曾通过技术授权和少量投资取得富士通 12 英寸厂 9.3% 股份，本次与厦门的合作可以看作是另一个尝试。

联电成熟产能的扩张，台企投资 12 英寸产线于大陆的破冰之举

对于联电而言，在全球 12 英寸设备开始完成折旧的时候，需要扩充 12 英寸产能以保持竞争力，但限于台湾当局技术出口限制，能够在大陆投资的最先进制程是 40nm，而大陆中芯国际已具备成熟的 40nm 量产能力，华力微的 40nm 也已接近成熟，对于大陆而言此项投资不具备技术上的吸引力。但考虑到这是首条由台企到大陆投资的 12 英寸产线，对于推动两岸在半导体领域的合作具有积极意义，预计政府会给予支持。

制造环节竞争加码，不改变中国 IC 产业大格局，利好下游封测产业

由于 12 英寸 55/40nm 的主要应用是嵌入式存储(应用于智能卡、汽车和工控 MCU、指纹识别)、CIS、LCD 驱动等，与 SMIC 现有业务有所重合。即使顺利审批，联电合资公司产能放出也要到 2 年以后，届时 SMIC28nm 已经大量量产并贡献强劲的盈利增长。

来源:全景网络

受全球经济向好驱动

我国 LED 照明产品出口市场迎来又一春

虽然中国 LED 照明产品在外销市场中时常会受到专利打压、标准限制、贸易壁垒等多方阻碍，但出口市场依旧火热。受全球整体经济环境向好驱动，我国 LED 照明产品出口市场迎来又一春。2014 年上半年我国照明产品出口总额达到 180 亿美元，同比增长约 16%。据行业机构对海关出口数据的分析表明，从出口目的地看，欧美仍是我国 LED 照明产品出口的主流市场。2011 至 2013 年对美整体出口额实现三年内翻超过两番。

美国照明市场凭借其总量大，增速快，产品需求丰富等众多优势一直被划分为我国 LED 照明产品最主要的出口市场。而今年年初全面禁白令、政府扶持政策频出，进一步促使美国 LED 照明市场需求量的快速增长。2013 年美国超过日本成为我国第一大出口市场国，出口总额达 8.14 亿美元，占到我国总体出口份额的 16.05%。

但是在我国对美出口金额高速增长的同时，出口 LED 照明产品价格却呈现持续下降的趋势。这种“量涨价跌”虽然没有拉低对美出口的总金额，但是这种“出工不见钱”的现状拉着很多 LED 照明出口企业走上了薄利多销之路。

根据数据显示，自 2012 年至 2013 年上半年，我国出口美国的数量一直保持高达 200% 左右的增长率，同期的价格以 10% 左右的速度呈现震荡式下滑，进入 2013 年下半年后，整体价格的下降趋势有所收缓。

在 LED 出口企业方面，目前中小企业仍是我国对美 LED 照明产品出口的主力军，出口订单小而散，“无牌”产品占主流，但比重在缩小。行业机构数据显示，在我国 2014 年上半年出口订单中，平均每单金额 2 万美元左右，80% 以上的订单金额均低于 3 万美元。

行业机构认为目前代工仍是对美出口的主要模式，自主品牌难凸显，也有部分企业在为国际品牌代工的同时积极发展自己的自主品牌，不管企业是以哪种形式进驻美国，目前美国市场持续走俏，在出口企业眼中都是块流着油的大肥肉，但是各类出口壁垒又迫使企业不得不考虑这“口”该怎么下，“佐料”该如何放。行业机构预计我国对美出口增长率还将持续，三四季度是传统出口旺季，预计 2014 年下半年出口将呈现更高增长。

来源:中国半导体照明网

中国西部探索“光伏治沙”新模式

中国西北地区有着中国最为丰富的太阳能资源，而这些地区也是中国受风沙侵袭最严重的地区。随着太阳能等新能源的开发，不少光伏电站建造及运营者开始探索光伏发电与荒漠治理相结合的“光伏治沙”模式，希望能走出一条工业治沙的新模式。

甘肃省武威市古浪县的马路滩位于腾格里沙漠的南缘，这里是受风沙侵袭最为严重的地区之一。2013年11月，由振发新能源投资建设的500MW光伏电站一期投入使用。该光伏电站开始把太阳能开发和荒漠治理相结合。

“治沙的效果非常明显，光伏电站区域的植物生长要明显好于其他地区。”古浪振业沙漠光伏发电有限公司负责人于德虎说，这主要得益于土地平整和光伏板的遮阴效果，使植物的生存环境有了很大改善。据于德虎介绍，振发古浪光伏沙漠生态电站最大的特色就是把发展光伏和沙漠治理、节水农业相结合，电站的外围用草方格沙障和固沙林组成防护林体系，光伏板下安装滴灌设施，种植绿色经济作物，实现经济效益和生态效益的共赢。

据了解，随着光伏电站的开发，行业竞争的加剧，把光伏发电和治沙相结合的模式已成为很多公司争取项目的筹码。

在武威市民勤县，兴业太阳能技术控股有限公司也计划走光伏治沙的新模式。而在2009年，振发新能源公司在宁夏中卫就已经建造了沙漠生态电站项目。

“光伏板的遮阴效果能使蒸发量减少20%到30%，这能很好改善植物的生存环境。”雷国庆说，生态的改善对太阳能发电同样是有利的。扬起的灰尘对发电量的影响比较大，而植物能减少灰尘的扬起。

据甘肃自然能源研究所所长、中国可再生能源学会副理事长喜文华介绍，光伏治沙的前景非常广阔，现在很多光伏电站仅仅是建电站，没有创新和竞争优势，对荒漠的利用方式粗放，土地价值并没有得到充分发挥。

“治沙植物研究不是光伏企业的长项，这就需要合作。但是目前这方面的合作却很少。”喜文华认为，由于缺乏专业的技术人员，不能有效将太阳能开发与节水灌溉技术进行有机结合，这是目前光伏治沙所面临的最大挑战。

来源:新华网

220 台蓝宝石长晶炉现已投产

兰州拟建 LED 蓝宝石最大生产线

从中国四联仪器仪表集团兰州新区基地了解到，目前该项目投资 10 亿元在兰州新区建设的中国四联高新技术西北产业基地，作为中国最大蓝宝石生产基地，拟建设 LED 封装及 LED 照明产品、高清电视机顶盒、城市供热计量表、第三代聚光太阳能发电系统生产线。

而纳入计划的蓝宝石生产项目规划，作为首期投资建设 220 台蓝宝石制造的国际、国内技术先进的长晶炉现已投产，这项高科技产品的下线也将有力助推兰州新区生态工业的发展，扩大兰州新区的就业需求。

据了解，日前，宁夏回族自治区银川市副市长、银川经济技术开发区管委会主任王久彬做客“中经在线访谈”栏目时就谈到，随着苹果和华为公司宣布智能手机屏采用蓝宝石，蓝宝石将成为银川的支柱性行业。王久彬透露，银川经济技术开发区正在打造全国最具影响力，也是最大的工业蓝宝石生产基地，到明年这个时候，蓝宝石产量就可以达到 1500 吨，届时也会形成国内最大、最有影响力的蓝宝石产业。

在访谈中，王市长也谈到了银川在蓝宝石产业方面的一些最新进展，“目前，我们把蓝宝石作为开发区一个重点跟踪打造的产业。我们引进了两家比较有规模的企业，现在已经量产。”

据悉，未来随着蓝宝石在苹果产品链及其他智能手机里的推广运用，预计蓝宝石需求比重将从 2013 年的 15% 提升至 2015 年的 55%。2014 年，用于智能手机等移动设备上的蓝宝石材料将和 LED 所用蓝宝石衬底数量相当；2015 年，将为 LED 用蓝宝石衬底需求的 2 倍，2015 年蓝宝石需求将是 2013 年的 5 倍。

来源:高工 LED

去年我国 LED 产业总产值为 2068 亿元 同比增长 34%

据预测，2014 年照明用芯片需求量将超过背光源，成为行业最大的应用。

2013 年以来，随着照明市场的逐步启动，LED 市场增长加快，全年产值达到 124 亿美元，增长率达到 17%。2014 年，产业增速进一步加快，预计全年产值将达到 178 亿美元。许文辉认为，由于 LED 在背光源领域的渗透率已超过 90%，而在照明市场的渗透率仅为 7%，因此未来的主要增长空间在照明领域。按照 DisplaySearch 的预测，2014 年，照明用芯片需求量将超过背光源，成为行业最大的应用。

“上一轮 LED 景气周期的主要驱动力是液晶背光源需求。背光源产品对于技术要求较高，美国、日本、韩国以及我国台湾地区的企业将重心放在了技术高、利润好的背光市场上；反观我国大陆企业，技术积累有限，主要承接显示屏等溢出型订单，行业地位相对边缘化。”许文辉表示，“本轮 LED 需求回暖的主要因素是照明。照明产品对 LED 芯片技术的要求总体上低于背光源，而过去几年国内 LED 芯片龙头企业通过研发投入和人才引进，在技术上取得了明显进步。”

来源:LED 在线

物联网**联发科创意实验室计划亮相 加速物联网开发**

联发科今天正式发表联发科技创意实验室(MediaTek Labs)全球计划,帮助不同背景与技术水平的产品开发者加速穿戴式和物联网装置的开发,此计划为全球开发者、创客(Maker)和服务供应商提供软件开发套件(SDK)、硬件开发套件(HDK)、技术文件与技术及商业上的全面支援。

联发科创意实验室项目初期将以 LinkIt 开发平台为主,平台主要以 Aster(MT2502)系统单晶片为核心。LinkIt 开发平台具备完整的联网功能和良好的扩充性,通过高度整合以降低额外硬体连接设备的数量。此外,联发科也提供的硬件参考设计,可让开发可穿戴及物联网原型设备的流程可更加简化且更具成本效益。

LinkIt 开发平台组成包括:系统单晶片(SoC) Aster 为全球体积最小、已商用的穿戴式 SoC,可搭配 Wi-Fi 和 GPS 晶片组提供高性能、低功耗表现,搭配 LinkItOS 平台,与深圳矽递科技(SeedStudio)合作的 LinkItONE 硬件开发套件,加上软件开发套件(SDK),创客可利用软体开发套件中所提供的应用程序界面(API)、将现有的 Arduino 编码迁移到 LinkItONE 上。

来源:苹果日报

物联网时代 芯片厂不再赢者通吃

手机晶片厂高通决定斥资 25 亿美元收购蓝牙晶片厂 CSR,加速扩大布局物联网。IEK 认为,物联网时代晶片厂将不再是赢者通吃,高通收购 CSR 对国内晶片厂影响应有限。

高通(Qualcomm)决定斥资 25 亿美元收购 CSR,若以高通宣布前一日 CSR 收盘价计,高通相当于溢价 37%收购 CSR,震撼市场。

市场普遍认为,高通高价收购 CSR 主要是瞄准下一个明星产业物联网。

只是有分析师认为,高通 3 年前即已收购无线通讯晶片厂创锐讯(Atheros),高通与 CSR 技术重叠性高,对于高通决定收购 CSR 感到不解。

工研院产业经济与趋势研究中心(IEK)电子与系统研究组副组长杨瑞临表示,蓝牙是未来物联网产业的关键技术之一,不过,高通收购 CSR 并不是仅着眼于技术、专利及产品。

杨瑞临指出,高通收购创锐讯,主要是为补强技术及专利,这次高通收购 CSR 应

主要着眼于 CSR 建构的生态系，CSR 过去在许多标准组织扮演相当重要角色。

高通透过收购 CSR，将有助加速扩大掌握领域，扩大出海口。

杨瑞临表示，除蓝牙外，无线区域网路也是物联网产业的关键技术，资讯安全在物联网也相当重要；预期国内外业者仍将不断透过并购方式，以快速补强技术的不足，产业并购风潮仍将持续不断。

物联网将是未来明星产业已成各界共识，晶圆代工龙头台积电(2330)认为，物联网将是继智慧手机、平板电脑之后，驱动台积电业绩再成长的新动力。

调研机构顾能(Gartner)预期，2020 年物联网装置可望达 260 亿个，市场将达 3090 亿美元规模。联发科(2454)董事长蔡明介也预期，物联网时代将有多达 200 亿至 500 亿个装置，规模庞大，只是商业模式将是大挑战。

杨瑞临说，未来物联网产业在万物联网的概念下，应用多元，且各应用领域运营模式也都将不同，预期物联网产业发展将与过去个人电脑及手机产业大者恒大发展趋势不同，将不再是赢者通吃，而是百家争鸣的局面。

高通收购 CSR 对联发科等国内晶片业者影响应有限，不过，国内晶片厂资源相对有限，难与高通一样，布局既广且深，杨瑞临认为，联发科等国内业者应慎选发展领域，避免与高通正面竞争，仍有发展契机。

来源:中央社

聚焦物联网、车联网和智能交通 展会论坛在沪开幕

2014 第五届中国国际物联网、车联网与智能交通展览会暨论坛 (IOT CHIAN 2014 & CVITS EXPO 2014) 于 2014 年 10 月 28 日至 29 日亮相上海世贸商城。

本届展会的主题为“物联万物、智慧生活”、“物联万物、智慧出行”，聚焦物联网、车联网和智能交通三大主题，内容涉及：物联网前沿技术、智慧城市与社区、车联网\智能交通、智慧医疗、智慧农业/食品安全、物联网投融资对接等相关领域。

跨界合作，构筑物联网全新生态圈

物联网作为物物相连的互联网，经过几年的迅猛发展，已经从传统的通讯行业间合作迅速演变成通讯与汽车、通讯与交通、通讯与医疗、通讯与农业、通讯与家电，物联网与资本运作等等跨行业的合作。物联网已将自己联物、移动与协作的强大特性，完全渗透到了城市生活的各行各业，不仅诞生了一系列全新的拓展性领域，更创造了无限的商机可能。可以预见，全新的物联网生态圈已悄然而生，将各自在本届展会上“智慧”呈现：

“智慧”体验 1：汽车物联网，开启智慧汽车和自动驾驶新未来

本届“车联网”将以主旨论坛和互动体验展示相结合：福特、丰田、通用、上汽、观致、吉利、比亚迪，以及信息服务商安吉星携手新款凯迪拉克、移动携手汉兰达、联通携手宝马、电信携手大众迈腾等，约 14 辆装载全新物联网驾驶应用的车型将充分体现车联网以车为核心载体，信息化为车联网核心，车联网信息化的应用为本质的智能、快捷、高效的车联网时代，从而实现车内网、车际网与车载移动互联网的“三网融合”。

“智慧”体验 2：交通物联网，智慧交通带动智能停车

本次展会与经信委和交通委共同深度合作，强强联手打造的智能交通领域，将汇集交通运输部公路科学研究院、上电科、公安三所和中国银联等，分别就智能交通设施建设、智能停车管理系统，特别是停车支付系统和出租车行业发展等相关议题展开讨论和案例分享，其中“智慧停车”作为独立议题被首次纳入。

“智慧”体验 3：健康物联网，迎来医疗领域划时代发展

移动查房、移动护理、移动急救，远程医疗、远程健康监测……这些在过去想也不会想的医疗方式，正借助物联网新技术萌芽。今年全新打造的“智慧医疗”领域，来自上海中山医院、儿童医院、上海市第一妇婴保健院、复旦大学附属第五人民医院、上海中医药大学，以及经信委、卫计委、民政局、药监局、欧盟代表等国内外健康物联网领域权威机构，将逐一展示来自数字医疗/远程医疗，大数据/云技术和健康管理，可穿戴设备的未来实际应用和基于智能手机的医院移动等应用。

“智慧”体验 4：农业物联网，成食品追溯和食品安全加速器

智慧农业/食品安全分论坛作为四大分论坛之一，将邀请到欧盟、日本、韩国、台湾地区专家学者，以及上海农业物联网应用工程技术研究中心上海复旦大学教授和其他中方行业代表，就各地在食品安全与智慧农业领域最新解决方案作案例分享。此外，中欧智慧农业/食品安全合作加速器分论坛将着重讨论中国市场准入问题及行业标准，并相互探讨中欧在这一领域的合作契机。

“智慧”体验 5：中欧物联网论坛，打造未来超级智慧城市

2007 至 2013 历时六年，由欧盟播种、欧洲物联网研究集团（IERC）耕耘、总预算为 505.21 亿欧元的第七个科技框架计划（7th Framework Programme）已结出丰硕成果。此次，在中欧物联网合作相融的大趋势下，欧洲物联网研究集团（IERC）与工信部联手举办的“中欧物联网论坛”也将作为配套活动举行，论坛涵盖车联网/智能交通、智慧农业/食品安全、智慧医疗、智慧城市/前沿技术四大主题，浦东新区和杨浦区展团也将作为上海智慧城市社区试点建设展示亮相。

来源：新华网

东北第一颗 32 位 CPU “吉湾一号” 在长春诞生

CPU 一直以来被视为集成电路设计领域的两弹一星级技术，我国企业掌握此技术的时间也不过 10 年左右，而在电子业薄弱的东北，如今也迎来了东北第一颗 32 位 CPU “吉湾一号”。

“吉湾一号”的设计研发前后历时 5 年，投资近千万。吉湾一号具有高性价比、安全、可信、无后门的特点，终端产品可在成本敏感、安全敏感由政府、企业等领域替代 PC。可作为政府构建自主可控、安全可靠的办公系统基础。

统计称：我国芯片市场销售规模达数千亿元，基本由国外公司垄断。据工信部下属科研机构统计，2013 年中国集成电路市场销售规模达 9166.3 亿元。但令人遗憾的是，如此庞大的市场，却由国外公司垄断，不但绝大部分利润由国外公司争取，还对我国国家安全带来威胁。“吉湾一号”的诞生为我国打破国际垄断，赢得国际上的话语权有着深远意义。

来源:中国吉林网

国家“核高基”项目创维 GLED 产品性能获国际领先水平

近日，创维在京发布了 GLED 极客互联网电视新品，会上集中展示了 GLED 代表产品 G8200 系列。GLED 是创维下阶段核心战略新品，其以超高配置 4 色 4K+屏，搭载国内尖端水平的电视芯片，使用高端 OLED 的图像处理技术。

据发布会上创维营销总部市场部总监杨孝骏介绍，GLED 全称 GreatLED，又称“极客互联网电视”是创维研发的全新一代 LED 电视。采用 4 色 4K+技术、14 核处理器、酷开系统及专业的后台服务。为了寻求新的突破，全面提升 LED 电视画质和可用性，创造出最完美的 LED 电视，创维联合 LGDisplay、华为海思等国内外顶级厂商，发起对 LED 电视终极攻坚战。经过长时间不懈探索，GLED 电视终于研发成功，呈现在世人面前。GLED 电视是在 LED 电视成像原理的基础上实现电视画面的全面颠覆性改良，配备以往只有 OLED 电视才具备的 4 色 4K 这一核心技术，成为 LED 电视的巅峰之作。

发布会结束的第二天，《新闻联播》针对本次发布会做出来相应内容的报道。报道中阐述：“中国本土企业自主研发的智能电视 SOC 芯片研制成功并首次实现量产。搭载这款芯片的新品的系统速度、解码能力等智能电视核心性能居行业领先水平。”

来源:中国电力电子产业网

苹果新款处理器 Q4 台积电 16nm 制程试产

晶圆代工龙头台积电（2330）全力冲刺 16 奈米鳍式场效电晶体（FinFET）制程，昨（25）日宣布与海思半导体（HiSilicon）合作，成功率先产出业界首颗以 FinFET 制程及 ARM 架构为基础且功能完备的网通处理器。业者分析，台积电 16 奈米 FinFET

制程投产成功，可望提前一季度时间，在今年第 4 季进入量产阶段。

同时根据设备业者消息，台积电 16 奈米 FinFETPlus 制程也进入试投片（tryrun）先前作业阶段，可望提前至第 4 季试产，主要客户除了绘图晶片厂辉达（NVIDIA）、可程式逻辑闸极列（FPGA）厂赛灵思（Xilinx）、手机晶片厂高通外，众所瞩目的苹果新款应用处理器也将试投片清单中。

台积电昨日宣布与海思半导体合作，成功产出业界首颗以 FinFET 制程及 ARM 架构为基础之功能完备的网通处理器，该晶片是以 ARMv8 架构为基础的 32 核心 ARM Cortex-A57 网通处理器，运算速度可达 2.6GHz。台积电的 16 奈米 FinFET 制程能够显著改善速度与功率，并且降低漏电流，有效克服先进系统单晶片技术微缩时所产生的关键障碍。

来源:工商时报

苏州建成 6 英寸 MEMS 中试线 填补国内创新链空白

日前中国—新加坡苏州工业园区举办了一场具有特别意义的 MEMS 传感器产品交付会，苏州纳米科技发展有限公司将 6 英寸微纳机电制造(MEMS)中试线的首个产品正式交付客户。这也意味着国内首条全开放、市场化运作的 6 英寸微纳机电制造(MEMS)中试线正式运营，该中试线的投用将为我国中小 MEMS 企业的发展带来福音。

“我国中小 MEMS 企业发展面临很多困难，其中一个关键的难题是产品的工程化与中试生产，规模代工厂门槛较高，高校院所的实验室工程化能力较弱或开放度不够，产品的工程化中试已成为影响中小 MEMS 企业规模化成长的瓶颈。”张希军告诉记者。

据了解，苏州 6 英寸微纳机电制造(MEMS)中试线采用市场化、全开放的运作模式，主要开展 MEMS 产品工艺研发、MEMS 加工、部分封装测试、专利运营、设备租赁、超净场地租赁、工艺技术培训等十多项专业服务，目前已成功导入压力传感器、微镜传感器、微流体传感器等产品，产品样品测试结果良好，基本具备了 MEMS 芯片的开发加工能力。

“发展 MEMS 产业，既要看清楚我们的优势，又要找准自身的不足。6 英寸微纳机电制造(MEMS)中试线只是苏州 MEMS 产业发展的新起点，要构筑 MEMS 产业生态圈，我们还需要全国的产业资源，来突破资源限制、人才限制、技术限制。”张希军长期担任苏州市集成电路行业协会秘书长，和半导体企业打了多年交道，对产业发展的核心要素有比较深的了解。

来源:中国电子报

我国集成电路高端装备自主化取得新突破

工业和信息化部近日，由北方微电子有限公司自主研发的 12 英寸 28 纳米等离子硅刻

蚀机，已经全面通过中芯国际集成电路制造有限公司的生产线全流程工艺验证，并获得客户订单。这标志着中国集成电路高端装备自主化取得了新的突破，并缩短了与国际一流设备的差距。

等离子刻蚀机是在硅片表面实现三维精细加工的高端设备，是集成电路制造中最核心的装备之一。当前，国际上进入量产的最高水平是 28 纳米技术，相比 40 纳米技术，可使集成电路的功耗更小、速度更快、成本更低，主要应用于 CPU、存储器、移动通信、数字音视频等高端芯片产品。目前，国际上仅美国和日本各有一家企业能够提供满足 28 纳米生产线的成熟设备。

由于技术门槛高，高端刻蚀设备成为长期制约我国集成电路产业发展的瓶颈。目前，我国大规模集成电路生产线(8-12 英寸)的芯片制造设备大量依赖进口，不仅严重影响我国集成电路产业发展，也对我国电子信息安全造成重大隐患。

北方微电子 28 纳米等离子硅刻蚀机通过自主创新，突破了精密等离子体控制、硅片表面温度精确控制、高气流均匀控制等多项关键技术，以全新的硬件设计达到了高速率、高均匀性、低损伤和低缺陷、精确尺寸和形貌控制、低颗粒污染等要求，多项关键指标达到国际先进水平。28 纳米刻蚀技术的突破，打破了国外对 28 纳米集成电路生产设备的技术封锁和市场垄断，缩短了与国际先进水平的差距。

来源:华强资讯

中国首款企业级 64 位 ARM 微服务器问世

10 月 22 日消息，霆云网络科技有限公司正式发布中国首款基于 64 位 ARM 芯片的微服务器产品。

霆云网络科技有限公司的 2U 机架式 C3200P 微服务器是一款具有低功耗、高密度的特性，并适合云计算、大数据的产品。该产品从 2012 年进行研制，投入了长期从事基于互联网企业级云系统研发的软件专家和在计算机硬件设计领域拥有十数年经验的硬件专家组建的专业团队，历时两年，终于在 2014 年 9 月生产出了中国第一台基于 64 位 ARM 芯片的微服务器产品。这款里程碑式的产品，解决了目前传统服务器能耗高、维护成本高、体积大等问题，满足了客户对下一代服务器产品高效率、低能耗之与日俱增的需求。在新型互联网时代，具有划时代的意义！

霆云网络科技 ARM64 微服务器内含 3 台独立抽拉式服务器，并拥有全球第一款基于 64 位 ARMv8-A 架构的 APMX-Gene 芯片，在保证云计算所要求的高强度性能的同时，极大地降低了功耗。整机最高可配 24 块 3.5 英寸硬盘，达到 192TB 的高密度存储容量，而整体运行功耗只有 340W，比同类型存储服务器节能高达 60%。在数据中心部署运营五年的总体拥有成本(TCO)比传统服务器降低了惊人的 40%~50%。

来源:华强资讯

关于召开 2014 中国半导体功率器件高可靠性技术研讨会的通知

随着过去几十年间全球通讯、照明，家电、汽车、工业控制、航空航天等各个领域的高速发展，半导体功率器件所属之电源行业也得以飞速增长。各大企业不约而同地专注于追求更为优异的性能指标、更高的功率密度以及更小的系统能耗以及解决方案的小型化等技术指标。但要实现这些指标的前提，必须以产品稳定的可靠性为前提。在产品的可靠性不断提高的前提下，降低成本以及设计高性能的新产品才是各家企业脱颖而出的关键路线。事实表明，科技给我们创造了美好的生活，低可靠性的产品却会带来灾难。以往经验证实低可靠性的产品会导致投诉、退货、巨额赔款等严重后果。

是否能有新的设计，新的工艺，新的材料，能让功率器件产品在实现更高成品率、更低成本、更优秀的性能参数的同时具备更高的可靠性？电源终端客户对功率器件的实际需求是什么？功率器件需要优先满足的是电源系统的性能指标，还是系统对于成本的需求？在控制成本的同时，怎样保证产品的可靠性？

为了解答这些问题，我们将于在 2014 年 11 月 27、28 两日，在西安举办 2014 中国半导体功率器件高可靠性技术国际研讨会，大会邀请来自国内外知名专家与学者及企业界高层等共 100 余名各领域菁英代表汇聚一堂，透过技术研讨与交流，针对如何从产品设计、制造、材料、质量管控、测试分析、应用方案等各个环节确保产品的高可靠性，从而提高国内半导体功率器件的设计、制造与测试水平。期待行业内精英踊跃报名，共商中国半导体功率器件之大计。

一、会议组织机构

指导单位：中国半导体行业协会

主办单位：中国半导体行业协会分立器件分会

承办单位：陕西省半导体行业协会、西安高新区企业协会

西安半导体功率器件测试应用中心

支持媒体：《半导体技术》、《开发区导报》、电源网、Global Sources、Bode's

二、针对产品和涉及领域：POWER DEVICE\LED\IC，可靠性与设计、可靠性与生产、可靠性测试、封装新材料等。

三、会议时间与地点

1、会议时间：2014 年 11 月 26 日报到，27 日至 28 日开会；

2、会议地点：陕西省西安市中兴和泰酒店二楼长安厅

西安市科学技术局、西安市财政局关于申报 2015 年度西安市科技计划项目及 2014 年度西安市现代服务业综合试点项目的通知

2015 年西安市科技计划以十八届三中全会精神为指导，进一步深化统筹科技资源改革，重点围绕打造小巨人领军企业、建设西安科技服务强市的目标任务，实施科技企业小巨人培育计划、科技服务业发展计划等八类计划。现将有关事宜通知如下：

网上填报时间：2014 年 10 月 27 日—2014 年 11 月 30 日（另行通知的除外）。

纸质材料受理时间：2014 年 11 月 10 日—2014 年 12 月 5 日。其中，科技服务业发展计划第一批项目 2014 年 10 月 30 日截止。

指南咨询，关于网上申报系统及纸质材料报送事宜，可咨询：

市科技局计划财务处	夏俊	86786630
市财政局企业处	宋高阳	87279709
西安科技大市场	张晓哲	68518787
市政务服务中心科技局窗口	胡成	86785043

详细内容请登录西安科技网查询 <http://www.xainfo.gov.cn/>

关于开展“第九届（2014 年度）中国半导体创新产品和技术项目”评选活动的通知

会员单位及有关单位：

2014 年随着《国家集成电路产业发展推进纲要》的发布，进一步激发了业界发展产业的积极性，有力的推动了我国半导体产业的发展。为鼓励产业创新发展，提升半导体产业的产品和技术水平，实现《纲要》到 2020 年与国际先进水平的差距逐步缩小，2030 年集成电路产业链主要环节达到国际先进水平的目标。中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会与中国电子报社将继续联合举办“第九届中国半导体创新产品和技术项目”评选（2014 年度）活动。

评选范围包括半导体产业的创新产品和创新技术。创新产品包括集成电路、分立器件、半导体设备和仪器、半导体专用材料；创新技术包括设计、制造、封装与测试等领域中开发的新技术。

中国半导体行业协会联系人：

白洁 010-68207275\13501096021 吴京 010-68208591\13901366795

详细内容请登录中国半导体行业协会查询

网址：<http://www.csia.net.cn/>